**經濟部產業發展署小量智造服務團參團申請須知**

為建構智慧物聯產業之少量多樣的產製環境，奠定軟硬整合發展基礎，並透過專家資源之導入，以提升創新產品之可量產程度。經濟部產業發展署成立「小量智造服務團」，透過盤整國內產製服務能量，協助軟硬整合產品/服務推動、開創商機，搭配輔導與媒合機制，實現智慧物聯產品之最小可行性產製生態鏈，奠定之關鍵領域之試量產生態體系推廣至國際，進而實現亞洲區具快速可量產潛力之物聯網智造基地。

有關「小量智造服務團」之申請、審查及輔導推動等相關行政作業，由經濟部產業發展署委託財團法人資訊工業策進會協助辦理。

主辦單位：經濟部產業發展署

執行單位：財團法人資訊工業策進會

1. **申請資格**
2. 依法辦理公司登記或商業登記之獨資、合夥事業或公司。
3. 具備可促進軟硬整合終端產品開發與產製服務之能力。
4. **參團效益**
5. 擴散媒合：參與產業發展署之產業推動與商洽媒合。
6. 技術整合：參與法人或廠商之研發合作，組成技術團隊，完成技術組合。
7. 資源轉介：鏈結創新產業，促成業務合作，衍生新型態產線開發。
8. 協同推廣：聯結跨界產學研單位，完成業務組合、服務實證與整合行銷。
9. **申請資料**
10. 小量試產服務資格檢核表。(附件1)
11. 小量智造服務團企業簡介與服務說明表(附件2)
12. 小量智造服務團參團同意書。(附件3)
13. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書(附件4)
14. 小量智造服務團保密切結書(附件5)
15. 其他，得自行附加其他佐證資料
16. **申請程序**
17. 申請企業於申請受理期間內，可於網址(<http://www.ideas-hatch.com/service_group.jsp>)線上申請，或下載相關資料填妥並回寄予執行單位。
18. 由執行單位針對資料完整性、申請企業之專業領域進行資格審查。
19. 採線上申請企業如審查通過，請填妥申請資料之【附件3-小量智造服務團參團同意書】回寄紙本文件予執行單位。
20. 符合資格之申請企業，由執行單位通知審查結果，得優先參與執行單位所籌辦之相關產業活動與業務媒合。
21. **收件日期**

114年度申請期間：即日起~114/10/31。於114/10/31後申請之業者，將以參與明年度相關產業活動/業務媒合為主。

1. **收件地點與諮詢服務**
2. 收件地點：財團法人資訊工業策進會 數位轉型研究院  
   （台北市松山區民生東路4段133號8樓）
3. 服務窗口：財團法人資訊工業策進會 數位轉型研究院  
    電話：02-6607-2574，崔小姐
4. 收件時間認定：
5. 線上申請：以系統記錄之送出申請時間為準。
6. 郵寄方式：以郵務單位郵戳時間為準。
7. 親送：以執行單位收件時間為準。
8. **其他資訊**
9. 申請資格經審查不符合者，不予受理。
10. 檢送之相關申請文件，無論是否通過審查，均不予退還。

**附件1：小量試產服務資格檢核表**

1. **是否成立公司?**

□是

□否

1. **是否在台具備自有工廠與產線?**

□是

□否，但可提供系統整合/layout/機構模具設計/fabless晶片設計…等產製服務。

1. **是否登記為生產或是外型製作商、且具備相對應的設備?**

□是

□否，請說明可提供哪些服務以支援產品試製：

1. **是否接受1,000 pcs以下生產量之訂單?**

□是

□否，請補充說明：

1. **是否具備相關認證?**

□是，包括＿＿＿＿＿＿＿

□否

1. **是否可接受協調派員駐點參與團隊諮詢與評選活動?**

□是

□否

**附件2：小量智造服務團企業簡介與服務說明表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請日期：　　　年　　月　　日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本資料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業名稱 |  | | | | | | | | | | | | 統一編號 | |  |
| 地址 | 縣　　　　鄉鎮　　 　　街　 　　段　 　　號  　　　　市　　　　市區　　 　　路　　 　弄　　 　樓 | | | | | | | | | | | | | | |
| 負責人 | □先生　□小姐 | | | | | | 職稱 | | | 聯絡電話 | | | ( ) | | |
|  | | | E-Mail | | |  | | |
| 聯絡人 | □聯絡人同負責人 | | | | | | | | | | | | | | |
| □先生　□小姐 | | | | | | 職稱 | | | 聯絡電話 | | | ( ) | | |
|  | | | E-Mail | | |  | | |
| 資本額 | 仟元 | | | | | | 營業額(去年) | | 仟元 | | | | 員工人數 | | 人 |
| 工廠地址 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 工廠登記證 |  | | | | | 水號 | |  | | | 電號 | | |  | |
| 企業簡介 | (※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業網址 | (※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊) | | | | | | | | | | | | | | |
| 參團類別  (可複選) | * 一般參團：提供產品開發軟硬整合技術服務。 * 國產IC推動專家團：針對物聯網智造基地選定之國產IC方案進行開發板/模組設計、教案設計、案例/產品實作等應用推廣。 * 國際推動小組：提供國際型團隊產品開發軟硬整合技術服務服務   (須具備至少一種外語溝通能力，如：□ 英文、□日文、□西班牙文、□法文、□韓文、□其他：\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | |
| 試製服務(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試製服務產品類型  (可複選) | | | □消費型電子 □穿戴式裝置□家電 □AR/VR用品 □車用 □大型場域應用 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| 主要試製服務之項目(可複選) | | | | | | | | | | | | | | | |
| □系統整合設計 | | | |  | □機電整合 | | | | | | | □晶片/電子元件，請說明類型：　如：CPU、感測元件、 通訊等 | | | |
| □系統組裝製作測  (如:SMT, Assembly等) | | | |  | □顯示裝置 | | | | | | | □晶片或模組封裝測試代工 | | | |
| □機構模具設計 | | | |  | □實驗室以及認證(安規、電磁、相容性、可靠度…等 | | | | | | | □機構材料(塑料射出、金屬加工…等) | | | |
| □PCB製作 | | | |  | □PCB Layout | | | | | | | □技術加值 | | | |
| □3D列印 | | | |  | □其他 | | | | | | |  | | | |
| 最少生產數量  (單選) | | □1~10pcs □11~100pcs □101~1000pcs □>1001pcs □其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 成功案例 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 國產IC方案(※勾選參加國產IC推動專家團必填欄位) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否有有國產IC方案之使用經驗 | | □ 無，但有興趣深入了解  □ 有，方案：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| 想了解/熟悉哪些國產IC方案(可複選) | | □ DSI 2598+（MT2625）  □ NuMaker-IoT-M487（NuMicro-M487）  □ OPL1000 EVB（Netlink OPL1000）  □ CoreMaker-01（M484SIDAE）  □ PU02/PH12（TS24GTR12S-P）  □ Filogic 130（MT7933/MT7931）  □ HUB 8735（Ameba， RTL8735B）  □ HUB 8735ultra (Ameba， RTL8735B )  □ HUB 5168+（RTL8720DN）  □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| 可提供上述國產IC方案哪些相關服務(可複選) | | □ 教案設計  □ 教學講師  □ 技術支援(如：使用諮詢、問題排除等)  □ 開發板/模組設計  □ 其他 | | | | | | | | | | | | | |

**附件3：小量智造服務團參團同意書**

茲 (請填寫企業名稱)　 申請加入經濟部產業發展署高階智造生態系統聯盟暨國際化推動計畫所籌辦之小量智造服務團，結合跨界能量，共同奠定國內軟硬整合發展基礎，建構智慧物聯產業之少量多樣的產製環境。

小量智造服務團參團類別：(至少一項，可複選)

* **一般參團**：提供產品開發軟硬整合技術服務。
* **國產IC推動專家團**：針對物聯網智造基地選定之國產IC方案進行開發板/模組設計、教案設計、案例/產品實作等應用推廣。
* **國際推動小組**：提供國際型團隊產品開發軟硬整合技術服務服務(須具備至少一種外語溝通能力，如：□英文、□日文、□西班牙文、□法文、□韓文、□其他：\_\_\_\_\_\_\_)

呈上茲同意加入成為小量智造服務團之成員，並參與由執行單位財團法人資訊工業策進會所舉辦之相關產業活動，以玆證明。

**企業名稱：**

請填寫企業名稱並加蓋公司大小章

中華民國114年　 月　 日

**附件4：蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

**經濟部產業發展署**

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

版本：P-CV25010121-1-DTRI

**經濟部產業發展署(下稱本署)**為遵守個人資料保護法令及本署個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

1. 蒐集目的及類別

本署因辦理或執行｢高階智造生態系統聯盟暨國際化推動計畫｣業務、活動、計畫、提供服務及供本署用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本署捐助章程所定業務、寄送本署或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：姓名、Email、性別、公司/學校、手機。

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式

除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本署於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

1. 當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或依以電子郵件方式（崔小姐，nicolechtsui@iii.org.tw）向本署行使下列權利：

1. 查詢或請求閱覽。
2. 請求製給複製本。
3. 請求補充或更正。
4. 請求停止蒐集、處理及利用。
5. 請求刪除您的個人資料。
6. 不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本署將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

1. 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本署留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述貴署告知事項。

1. 本人同意貴署於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：

中華民國 114 年 月 日

**附件5：小量智造服務團保密切結書**

立約人同意就雙方因進行物聯網智造基地之合作案（下稱「合作案」），所持有或知悉他方之機密資訊，約定保密事項及保密義務如下：

1. 本切結書所稱「機密資訊」，係指揭露方(物聯網智造基地團隊，下稱「揭露方」)交付收受方(小量智造服務團，下稱「收受方」)並註明為機密或其他同義文字之有形資訊，或揭露方以口頭方式向收受方揭露且於揭露時聲明其為機密，並於嗣後以書面追認其為機密之資訊。
2. 收受方對於下列資訊，不負保密責任：

（一）收受方於參加物聯網智造基地相關輔導活動前已為其合法持有或知悉之資訊。

（二）收受方自無保密義務之第三人合法取得或知悉之資訊。

（三）非因收受方之故意或過失而公開或為眾所周知之資訊。

（四）收受方（包括但不限於其員工、顧問或合作廠商）未使用任何機密資訊而自行研發或發現之資訊。

1. 保密義務

（一）收受方應盡善良管理人之注意義務，保管揭露方所揭露之機密資訊。未經揭露方事前書面同意，不得以任何方式直接或間接交付或洩漏機密資訊予第三人，且不得為超出合作案目的範圍利用或使用機密資訊。

（二）收受方應負責使其員工遵守本契約之保密義務。

（三）收受方因進行合作案而有揭露機密資訊予第三人之必要時，應事前取得該第三人同意依本契約約定保守機密資訊之書面承諾並經揭露方書面同意，收受方並就該第三人承諾負連帶履行之義務。若該第三人違反保密義務，視為收受方之違反，收受方應依本契約第五條之規定，對揭露方負損害賠償責任。

（四）收受方依法院或主管機關之命令而須揭露機密資訊時，應於收到該命令後立即通知揭露方，並配合揭露方採取合理必要之保密措施。

（五）本條保密義務之有效期間自揭露方向收受方揭露機密資訊時起算2年，不受本契約有效期間屆滿之影響。

1. 揭露方向收受方揭露之機密資訊，其所有權、專利權、著作權、營業秘密或技術秘竅（KNOW-HOW）係揭露方或其原授權人所有，不因揭露方揭露予收受方而生任何讓與、授權或權利設定之效力，收受方不得據以自行實施或申請專利權、著作權或其他智慧財產權，或使第三人行使上述權利。
2. 收受方如有違反本契約任何條款，揭露方得隨時要求收受方返還或銷毀機密資訊及其所有之重製物外，如另受有損害，並得請求收受方賠償之。
3. 收受方如發現第三人未經授權而違法使用機密資訊，應立即通知揭露方，並配合揭露方採取必要之排除或防止措施。
4. 本切結書自簽署日起生效，有效期間至合作案終止或完成時止。

立同意書人：

中華民國114 年 月 日